



Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de producto o componente	Módulo do processador
Aplicación específica de producto	Para entornos duros

Complementario

Número de racks	4
Local I/O processor capacity (discrete)	2048 E/S
Local I/O processor capacity (analog)	512 E/S
Number of application specific channel (local rack)	72
E/S específica de aplicación	Marca de hora precisa Contador SSI encoder HART Serial link Motion control
Comprobaciones	Control proceso
Canais de controle	Retornos programáveis
Tipo de conexión integrada	1 Ethernet TCP/IP para service port (*) 2 Ethernet TCP/IP para device network (*) USB tipo mini-B
Number of distributed equipment	128
Processador do módulo de comunicação	2 Módulo de comunicação Ethernet 4 Módulo AS-Interface
Servicio de comunicación	DIO scanner
Descripción de memoria	Ampliable parpadeo, 4 GB para almac. datos Integrado RAM, 10 kB para system memory (*) Integrado RAM, 8 MB para programa Integrado RAM, 768 kB para datos
Estructura de aplicación	2 auxiliary tasks 64 tarefas de eventos 1 tarea maestra cíclica/periódica 1 tarea rápida periódica
Número de instruções por ms	30 Kinst/ms 65% Booleano +35% aritmética fixa 40 Kinst/ms 100% booleano
Consumo de corriente	270 mA en 24 V DC
Confiabilidad MTBF	775000 H
Marcado	CE

Entorno

Resistencia a las vibraciones	3 gn
Resistencia a los choques	30 gn
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con
Humedad relativa	5...95 % en 55 °C sin condensación
Grado de protección IP	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2014/34/EU - ATEX directive
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]Generador[RETURN]Merchant Navy ((*)) [RETURN]Zona ATEX 2/22[RETURN]IECEx zona 2/22
Normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G IEC 60079-0
Características ambientales	Gas resistant class Gx acorde a ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 acorde a IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3 Salt resistant level 2 acorde a IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3 Lugares peligrosos class I division 2 ((*))
Tratamiento de protección	Conformal coating
Alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
LED de estado	1 LED (verde) processador em execução (RUN) 1 LED (rojo) falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (rojo) falha do módulo E/S (E/S) 1 LED (verde) descarga en curso (DL) 1 LED (rojo) Tarjeta de memoria o falla flash de la CPU (BACKUP) 1 LED (verde/rojo) ETH MS (estado de configuración del puerto Ethernet) 1 LED (verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet)
Peso del producto	0,849 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	883,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,901 kg

Sostenibilidad de la oferta

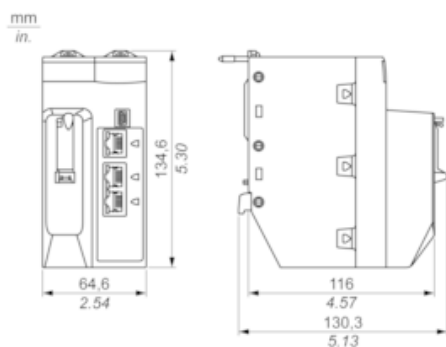
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

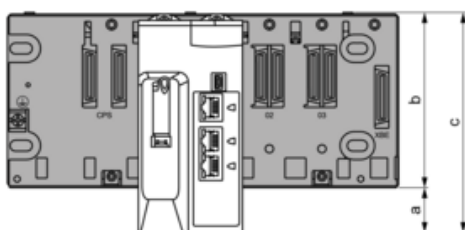
Hoja de datos del producto BMEP582020H

Esquemas de dimensiones

Sólo módulo CPU



Módulos montados en bastidores

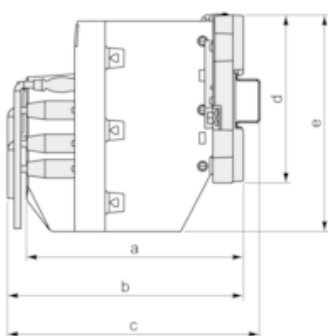


a: Espacio adicional debajo del bastidor para acomodar la altura de la CPU. Para un bastidor X Bus, el valor es de 30,9 mm (1,217 pulg.); para un bastidor Ethernet, el valor es de 29,49 mm (1,161 pulg.).

b: la altura del bastidor. Para un bastidor X Bus, la altura es de 103,7 mm (4.083 in); para un bastidor Ethernet, la altura es de 105,11 mm (4.138 in).

c: la altura del bastidor local principal es de 134,6 mm (5.299 in)

Módulos y cables montados en una carcasa



a: profundidad de la carcasa: 135 mm (5.315 in)

b: profundidad de cableado + módulo: > 146 mm (5.748 in)

c: profundidad de cableado + módulo + segmento DIN: > 156 mm (6.142 in)

d: altura del bastidor: para un bastidor X Bus 103,7 mm (4.083 in); para un bastidor Ethernet, 105,11 mm (4.138 in)

e: altura del módulo: 134,6 mm (5.299 in)